

蒐集個人資料告知事項暨個人資料提供同意書

數位發展部數位產業署 委託計畫執行單位-台北市電腦商業同業公會辦理跨域資安強化產業推動計畫（以下簡稱本計畫），因應個人資料保護法及相關個人資料保護規定，在向您蒐集個人資料之前，依法向您告知下列事項，當您填寫申請書時，表示您已閱讀、瞭解並同意接受本同意書之所有內容：

一、蒐集目的及類別

為本計畫相關報名作業管理、通知聯繫、活動訊息發布、問卷調查、相關統計分析之蒐集目的，而須獲取您下及列個人資料類別：姓名、電話、E-mail、公司、職稱。

二、個人資料利用之期間、地區、對象方式

您的個人資料，除涉及國際業務或活動外，將提供本機關(構)於中華民國領域，於上述蒐集目的之必要合理範圍內加以利用至前述蒐集目的消失為止。

三、當事人權利行使

依據個人資料保護法第 3 條，您可向計畫執行單位請求查詢或閱覽、製給複製本、補充或更正、停止蒐集/處理/利用或刪除您的個人資料。

四、不提供個人資料之權益影響

如您不提供或未提供正確之個人資料，或要求停止蒐集/處理/利用/刪除個人資料、服務訊息的取消訂閱，本機關(構)將無法為您提供蒐集目的之相關服務。

五、各項通知服務、相關訊息之停止寄送

您可於上班時間聯繫計畫執行單位活動承辦人（電話(02)2577-4249，分機：923）。

六、個人資料同意提供：

1. 本人確已閱讀並瞭解上述告知事項，「同意」授權本機關(構)於所列目的之必要合理範圍內，蒐集、處理及利用本人之個人資料。
2. 本人瞭解此同意書符合個人資料保護法及相關法規之要求，並同意提供予貴機關(構)留存及日後查證使用。

系列產品申請「物聯網資安標章」廠商自我宣告表

本標章使用權者 _____
(下稱宣告機構)

主產品證書編號	
宣告機構名稱	
主產品	設備名稱： 設備型號： 韌體檔名： 韌體版本： 主機板通訊晶片：請填晶片型號 主機板微控制晶片：請填晶片型號 主機板影像晶片：請填晶片型號 SVN/git Path：版本管控與路徑的表示方式 Build：軟韌體版本(如 v0.48a build20211123) Revision: 軟韌體版次
系列產品-1	設備名稱： 設備型號： 韌體檔名： 韌體版本： SVN/git Path：版本管控與路徑的表示方式 Build：軟韌體版本(如 v0.48a build20211123) Revision：軟韌體版次(如系列產品版本更新版次) 主機板通訊晶片:請填晶片型號 主機板微控制晶片:請填晶片型號 主機板影像晶片:請填晶片型號 與主設備差異說明(若勾選否，請列舉說明): 1. 「外觀」是否相同 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，說明： 請提供差異性項目說明 (ex.主產品外觀為球型，系列產品為槍型) 請說明差異處是否有影響資安檢測的項目 2. 「主機板」是否相同 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，說明： 請提供差異性項目說明 請說明差異處是否有影響資安檢測的項目 3. 「韌體」hash 值是否相同 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，說明： 請提供系列產品 HASH 值 請說明差異處是否有影響資安的檢測項目 4. 「系統組態設定」是否相同 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，說明： 請提供差異性項目說明(ex.密碼存在有差異) 請說明差異處是否有影響資安檢測的項目 5. 其他



連絡窗口	姓名： 電話： 傳真： e-mail： 分機：
------	-------------------------------------

此致

物聯網資安認驗證制度推動暨驗證機構

宣告機構用印	宣告機構負責人簽名或蓋章

宣告日期：民國 年 月 日